

請求の範囲

- [請求項1] 半導体基板上の接着層を、剥離用組成物を用いて剥離する工程を含む、半導体基板の洗浄方法であって、
上記剥離用組成物が、溶媒を含み、塩を含まず、
上記溶媒が、炭素数8～10の直鎖状脂肪族飽和炭化水素化合物からなることを特徴とする、半導体基板の洗浄方法。
- [請求項2] 上記炭素数8～10の直鎖状脂肪族飽和炭化水素化合物が、*n*-オクタン、*n*-ノナン及び*n*-デカンから選択される少なくとも1種である請求項1記載の半導体基板の洗浄方法。
- [請求項3] 上記接着層が、シロキサン系接着剤、アクリル樹脂系接着剤、エポキシ樹脂系接着剤、ポリアミド系接着剤、ポリスチレン系接着剤、ポリイミド接着剤及びフェノール樹脂系接着剤から選ばれる少なくとも1種を含む接着剤成分（S）を含む接着剤組成物を用いて得られる膜であることを特徴とする請求項1又は2記載の半導体基板の洗浄方法。
- [請求項4] 上記接着剤成分（S）が、シロキサン系接着剤を含む請求項3記載の半導体基板の洗浄方法。
- [請求項5] 上記シロキサン系接着剤が、ヒドロシリル化反応により硬化するポリオルガノシロキサン成分（A）を含む請求項4記載の半導体基板の洗浄方法。
- [請求項6] 上記接着剤組成物が、剥離剤成分（B）を含む請求項3～5のいずれか1項記載の半導体基板の洗浄方法。
- [請求項7] 上記接着剤組成物が、上記剥離剤成分（B）を上記接着剤成分（S）に対して25質量%以上含む請求項6記載の半導体基板の洗浄方法。
- [請求項8] 半導体基板と、支持基板と、接着剤組成物から得られる接着層とを備える積層体を製造する第1工程、
得られた積層体の半導体基板を加工する第2工程、

支持基板から、半導体基板及び接着層を分離する第3工程、及び半導体基板上の接着層を剥離用組成物を用いて剥離する第4工程を含む、加工された半導体基板の製造方法において、上記剥離用組成物が、溶媒を含み、塩を含まず、上記溶媒が、炭素数8～10の直鎖状脂肪族飽和炭化水素化合物からなることを特徴とする加工された半導体基板の製造方法。

[請求項9] 上記炭素数8～10の直鎖状脂肪族飽和炭化水素化合物が、n-オクタン、n-ノナン及びn-デカンから選択される少なくとも1種である請求項8記載の加工された半導体基板の製造方法。

[請求項10] 上記接着層が、シロキサン系接着剤、アクリル樹脂系接着剤、エポキシ樹脂系接着剤、ポリアミド系接着剤、ポリスチレン系接着剤、ポリイミド接着剤及びフェノール樹脂系接着剤から選ばれる少なくとも1種を含む接着剤成分(S)を含む接着剤組成物を用いて得られる膜であることを特徴とする請求項8又は9記載の加工された半導体基板の製造方法。

[請求項11] 上記接着剤成分(S)が、シロキサン系接着剤を含む請求項10記載の加工された半導体基板の製造方法。

[請求項12] 上記シロキサン系接着剤が、ヒドロシリル化反応により硬化するポリオルガノシロキサン成分(A)を含む請求項11記載の加工された半導体基板の製造方法。

[請求項13] 上記接着剤組成物が、剥離剤成分(B)を含む請求項10～12のいずれか1項記載の加工された半導体基板の製造方法。

[請求項14] 上記接着剤組成物が、上記剥離剤成分(B)を上記接着剤成分(S)に対して25質量%以上含む請求項13記載の加工された半導体基板の製造方法。

[請求項15] 半導体基板を洗浄する際に上記半導体基板上の接着層を剥離するために用いられる剥離用組成物であって、溶媒を含み、塩を含まず、

上記溶媒が、炭素数 8 ～ 10 の直鎖状脂肪族飽和炭化水素化合物からなることを特徴とする剥離用組成物。

[請求項16] 上記炭素数 8 ～ 10 の直鎖状脂肪族飽和炭化水素化合物が、*n*-オクタン、*n*-ノナン及び*n*-デカンから選択される少なくとも 1 種である請求項 15 記載の剥離用組成物。

[請求項17] 上記接着層が、シロキサン系接着剤、アクリル樹脂系接着剤、エポキシ樹脂系接着剤、ポリアミド系接着剤、ポリスチレン系接着剤、ポリイミド接着剤及びフェノール樹脂系接着剤から選ばれる少なくとも 1 種を含む接着剤成分 (S) を含む接着剤組成物を用いて得られる膜であることを特徴とする請求項 15 又は 16 記載の剥離用組成物。

[請求項18] 上記接着剤成分 (S) が、シロキサン系接着剤を含む請求項 17 記載の剥離用組成物。

[請求項19] 上記シロキサン系接着剤が、ヒドロシリル化反応により硬化するポリオルガノシロキサン成分 (A) を含む請求項 18 記載の剥離用組成物。

[請求項20] 上記接着剤組成物が、剥離剤成分 (B) を含む請求項 19 記載の剥離用組成物。

[請求項21] 上記接着剤組成物が、上記剥離剤成分 (B) を上記接着剤成分 (S) に対して 2.5 質量%以上含む請求項 20 記載の剥離用組成物。